

关于天水华天科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2019]62070013 号

天水华天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天水华天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

本鉴证报告仅供贵公司 2018 年度配股公开发行证券使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2018 年度配股公开发行证券的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

张海英

中国·北京

中国注册会计师：

魏兴花

2019 年 4 月 27 日

天水华天科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的基本情况

1、非公开募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2411号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2015年11月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）122,624,152股（以下简称“非公开”），每股发行价格为16.31元，募集资金总额为1,999,999,919.12元，扣除发行费用26,242,624.15元后的实际募集资金净额为1,973,757,294.97元。该募集资金已于2015年11月18日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]62020008号《验资报告》。

2、非公开募集资金在专项账户的存放情况

公司设立募集资金专项账户对非公开募集资金实行专户存放。公司及其子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）、华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“华天昆山”）分别在中国银行股份有限公司天水分行、中国民生银行股份有限公司西安分行文景路支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行开设非公开募集资金专项账户。2015年11月27日，公司及其子公司华天西安、华天昆山和瑞信方正证券有限责任公司与各非公开募集资金专项账户开设银行分别签订了《天水华天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

根据公司《2015年度非公开发行A股股票预案》及公司发行申请文件的安排，2015年11月20日，公司通过非公开募集资金专户向华天昆山增资51,000.00万元，用于募集资金投资项目“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目”实施。2015年11月25日，公司通过非公开募集资金专户向华天西安增资61,000.00万元，用于该募集资金投资项目“智能移动终端集成电路封装产业化项目”实施。

截至2018年12月31日，非公开募集资金专户存放情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息和理财收入	已使用金额	截止日余额	备注
天水华天科技股份有限公司	中国银行股份有限公司天水分行	104049728990	853,757,294.97	6,412,395.06	860,169,690.03	-	已销户
华天科技（西安）有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行文景路支行	695848553	610,000,000.00	6,371,254.58	616,371,254.58	-	已销户
华天科技（昆山）电子有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	32250198648300000016	510,000,000.00	10,440,397.20	520,440,397.20	-	已销户
合计			1,973,757,294.97	23,224,046.84	1,996,981,341.81		

二、前次募集资金使用情况说明

1、非公开募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开募集资金 1,996,981,341.81 元（含存款利息和理财收入），非公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、非公开募集资金投资项目变更情况

非公开募集资金投资项目未发生变更。

3、非公开募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况

非公开募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。

4、临时将闲置非公开募集资金用于其他用途的情况

2015 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响非公开募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置的非公开募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 7 亿元，期限自董事会审议通过之日起十二个月。在上述最高额度及期限内，资金可以滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已无使用非公开募集资金购买理财产品的情况，累计获得理财产品收益为 14,571,402.05 元。

5、尚未使用的非公开募集资金使用计划和安排

截止 2018 年 12 月 31 日，非公开募集资金已全部使用完毕。

6、非公开募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

非公开募集资金项目承诺投资金额 1,973,757,294.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日实际投资金额 1,996,981,341.81 元（含已投入的非公开募集资金利息和理财收入 23,224,046.84 元），差额全部为非公开募集资金存款利息和理财收入，各项目差异情况如下：

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额 (1)	截至 2018 年 12 月 31 日实际投资金额		差额 (2) + (3) - (1)
		募集资金 (2)	募集资金利息及理财收入 (3)	
集成电路高密度封装扩大规模	553,757,294.97	553,757,294.97	6,412,395.06	6,412,395.06
智能移动终端集成电路封装产业化	610,000,000.00	610,000,000.00	6,371,254.58	6,371,254.58
晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化	510,000,000.00	510,000,000.00	10,440,397.20	10,440,397.20
补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00

7、非公开募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以人民币 366,274,648.93 元非公开募集资金置换预先投入“集成电路高密度封装扩大规模”项目、“智能移动终端集成电路封装产业化”项目和“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目的自筹资金。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构瑞信方正证券有限责任公司就本次募集资金置换情况分别出具了专项报告。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、非公开募集资金投资项目实现效益情况

非公开募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2，募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、非公开募集资金投资项目实现效益的情况说明

非公开募集资金用于“集成电路高密度封装扩大规模”项目、“智能移动终端集成电路封装产业化”项目、“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”和“补充流动资金”项目，各项目实现效益情况分别说明如下：

（1）集成电路高密度封装扩大规模项目

该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。该项目 2015 年至 2017

年累计实现效益 8,894.35 万元，2018 年实现效益 5,193.27 万元，占当期承诺效益的 84.72%。

(2) 智能移动终端集成电路封装产业化项目

该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。该项目 2015 年至 2017 年累计实现效益 10,253.26 万元，2018 年实现效益 6,399.72 万元，占当期承诺效益的 85.01%。

(3) 晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目

该项目已实施完成，于 2017 年 12 月达到可使用状态。2015 年至 2017 年累计实现效益 1,788.46 万元，2018 年实现效益-4,135.04 万元。

(4) 补充流动资金项目

该项目已于 2015 年 12 月实施完成。公司未在《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等披露文件中对“补充流动资金”项目做任何形式的效益承诺。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

(三) 募集资金投资项目是否存在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%以上的情形

晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目于 2017 年底达到预定可使用状态，项目自达到可使用状态至 2018 年 12 月 31 日，项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%的主要原因为：项目采取边建设、边生产的方式进行实施。项目于 2015 年完成厂房和动力配套建设及封装技术产业化转换，从 2016 年开始按照边购置设备、边投入生产的方式持续进行项目产能建立，2017 年底项目建设完成。2018 年由于新客户认证周期长，新客户新增订单未达预期；且下半年半导体行业景气度下降，客户订单需求放缓；项目 Bumping 系列产品中比特币封装产品订单大幅下滑等因素造成项目收益未达预期。

四、前次发行中以资产认购股份的资产的情况

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金使用管理办法》管理募集资金专项账户；按照非公开发行预案以及可转债募集说明书披露的募集资金运用方案使用募集资金，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件 1:

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: (人民币) 元

募集资金总额:			1,973,757,294.97			已累计使用募集资金总额:			1,996,981,341.81	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例 (%) :			0.00			2015 年:			783,670,443.32	
						2016 年:			835,249,121.86	
						2017 年:			320,407,062.01	
						2018 年			57,654,714.62	
投资项目			募集资金投资总额			募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	集成电路高密度封装扩大规模	集成电路高密度封装扩大规模	580,000,000.00	553,757,294.97	560,169,690.03	580,000,000.00	553,757,294.97	560,169,690.03	6,412,395.06	2017 年 12 月 31 日
2	智能移动终端集成电路封装产业化	智能移动终端集成电路封装产业化	610,000,000.00	610,000,000.00	616,371,254.58	610,000,000.00	610,000,000.00	616,371,254.58	6,371,254.58	2017 年 12 月 31 日
3	晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化	晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化	510,000,000.00	510,000,000.00	520,440,397.20	510,000,000.00	510,000,000.00	520,440,397.20	10,440,397.20	2017 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	2015 年 12 月 31 日

附件 2:

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止 2018 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率（注 1）	承诺效益	2015 年至 2018 年实际效益				截止 2018 年累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年		
1	集成电路高密度封装扩大规模	99.13%	6,130.00	0.00	3,592.95	5,301.40	5,193.27	14,087.62	否（注 3）
2	智能移动终端集成电路封装产业化	99.96%	7,528.00	0.00	3,781.94	6,471.32	6,399.72	16,652.98	否（注 3）
3	晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化	39.20%	6,090.00	0.00	763.09	1,025.37	-4,135.04	-2,346.58	否（注 3）
4	补充流动资金（注 2）	不适用	不适用						不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：公司未在《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等披露文件及发行申请文件中对“补充流动资金”项目做任何形式的效益承诺。

注 3：集成电路高密度封装扩大规模项目、智能移动终端集成电路封装产业化项目和晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目建设期均为三年，项目实施分步分期，分批验收投产，上述项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态。

